

**160 $\mu$ m ピッチ  
「RFデバイス検査用プローブカード」製品化**

株式会社 ヨ コ オ  
東京都北区滝野川 7-5-11  
TEL:03-3916-3111(代表)

#### ■要 旨

(株)ヨコオでは、高周波デバイスの前工程検査市場向け「160 $\mu$ mピッチ・RFデバイス検査用プローブカード」をこのほど製品化しました。

#### ■市場動向と当社の取組み

当社は、当社のコア技術である“微細精密加工技術”および“高周波技術”を活用し、半導体の前工程後工程いずれの工程にも検査治具を供給できるメーカーとして、世界市場で事業を展開しています。

特に、今後さらに検査需要が高まると予測される前工程プローブカード事業分野では、高周波デバイスのWLCSP(※)高周波検査市場をターゲットとしたプローブカード(YVHシリーズ)を販売しています。これまでの同シリーズ製品は200 $\mu$ mピッチ以上のデバイスに対応するものでありましたが、当社はさらに狭ピッチ化を進め、今回「160 $\mu$ mピッチ」でのWLCSPの高周波検査が可能なプローブカードを完成させました。

【YVHシリーズ:ヨコオ垂直型ハイギガプローブカード(Yokowo Vertical High-giga probecard)】

#### ■プローブカード・YVHシリーズの特長

高周波に対応した前工程検査用プローブカードは、メンブレン方式(※)が一般的であります。同方式はメンテナンスが容易ではないことが欠点であり、ランニングコストが高くなる原因となっています。

これに対し、当社のプローブカード・YVHシリーズは、プローブピンコンタクト方式であるところから、検査の現場でプローブ交換が可能であり、メンテナンス性に優れているとともに、プローブを同軸構造にすることでインピーダンス整合をとるようにしているため、RF検査で問題となる損失、クロストークの低減を達成しています。更に、プローブを実装しているハウジング全体をGND(グラウンド)構造としているため、GNDインダクタンスの低減、デバイス的高速動作時に問題となるGNDノイズの抑制に寄与しています。

前工程における高周波検査の需要は、需要増が予測される次世代携帯端末、衛星通信、光デバイス、車載レーダー向けICなど高速、多機能ICの検査市場においてますます強まっており、当社では、このような製品が前工程検査の品質向上に寄与するものと考えています。

## ■ 160 $\mu$ mピッチ・RFデバイス検査用プローブカードの概要

### ◆ 特 長

- ・ 一般RF用プローブカードに比べ、ローコスト
- ・ 優れた高周波特性
- ・ ストロークが大きい
- ・ 単品（1ピン）交換可
- ・ マルチサイト対応
- ・ ハンドテスト（評価時）とのデータ相関が容易  
(プローブカードと同一コンタクタ使用可)
- ・ マルチサイト化により、2000ピン以上のコンタクトも可能

### ◆ 仕 様

- ・ インサーション ロス(挿入損失) : 4GHz@-1dB
- ・ リターン ロス (反射損失) : 6GHz@-10dB
- ・ GNDインダクタンス : <0.5nh/ピン

### 【語句説明】

※ WLCSP : Wafer Level Chip Scale Package

※ メンブレン方式

: 尖形のプローブ端子および配線パターンを、軟質フィルム状シートに形成した構造のプローブカード。

★本件に関するお問い合わせ先  
CTC事業部  
TEL : 03-3916-3116

以 上